

证券代码：688079

证券简称：美迪凯

杭州美迪凯光电科技股份有限公司
投资者关系活动记录表

编号：2025-003

投资者关系活动类别	☐ 特定对象调研 ☐ 分析师会议 ☐ 媒体采访 ☒ 业绩说明会 ☐ 新闻发布会 ☐ 路演活动 ☐ 现场参观 ☐ 其他
参与单位名称及人员姓名	网上投资者
时间	2025 年 9 月 10 日 9:00-10:00
地点	上海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址： https://roadshow.sseinfo.com ）
上市公司接待人员姓名	董事长兼总经理：葛文志 副总经理兼董事会秘书：王懿伟 副总经理兼财务总监：华朝花 独立董事：裘益政
投资者关系活动主要内容介绍	Q1：请葛总介绍一下，美迪凯未来发展规划，以及新厂的进展程度，以及国际化发展路径，以及和那些大厂有合作和产业链关系，众所周知，现在大 A 指数已经 3800，美美的股价远远落后于大盘，落后于科创板指数，公司在中报中提到了市值管理一说，葛总将如何积极落实市值管理工作，给大小股东提振信心，也不枉大家多年的等待，谢谢，希望诚切的回复一下。 答：尊敬的投资者，您好！未来，公司将继续深耕光学光电子和半导体行业的细分领域。半导体声光学和半导体封测业务已经呈现出快速增长的态势，半导体工艺键合棱镜、MicroLED 等新产品有望给公司业务增长带来新的动力。 公司杭州新基地正有序推进中，整个建筑工程已于 2025 年 6

	月份完成规划验收。公司将进一步加强项目管理、统筹力度，按计划推进项目进度。 面对市场环境的变化，公司坚持“国内深耕”与“海外拓展”双线并进，在海外市场，通过收购海硕力及越南工厂，成功切入三星供应链体系；与日本、韩国子公司协同，进一步完善了海外布局。 二级市场股价受多重因素影响，公司始终认为扎实经营、规范运作以及与市场保持诚实透明的沟通是市值管理的基础和关键，使公司市值能真实反映其内在价值，并致力于为股东创造长期稳定的回报。感谢您的关注与支持！ Q2：公司 2025 年上半年营业收入同比显著增长，主要是哪些产品贡献的收入？ 答：尊敬的投资者，您好！2025 年上半年，公司营业收入为 2.91 亿元，同比增长 35.05%，主要为半导体声光学、半导体封测销售收入增加，具体产品主要包括：超声波屏下指纹识别芯片整套声学层解决方案及后道封测工艺、图像传感器（CIS）整套光路层解决方案、射频芯片封测产品和功率器件封测产品等。感谢您的关注和支持！ Q3：公司上半年产能利用率是多少？三季度的产能利用率多少？ 答：尊敬的投资者，您好！公司目前仍处于产能爬坡期。超声波指纹芯片整套声学层及后道封测工艺、图像传感器（CIS）光路层解决方案等已实现量产；半导体工艺键合棱镜已开发成功并获得客户认可；MicroLED 项目也已完成全流程工艺开发，实现小批量投产。随着以上产品逐步放量及新产品逐步量产，后续产能利用率将持续提升。感谢您的关注和支持！ Q4：公司 2025 年半年度报告显示，扣除股份支付影响后的净利
--	---

	润约-3400 万，较上年同期的-5300 万有所收窄，主要是什么原因？ 答：尊敬的投资者，您好！公司 2025 年半年度报告显示，在扣除股份支付影响后净利润为-3449.47 万元，亏损额较上年同期收窄 1,920.44 万元。主要原因为公司 2025 年上半年营业收入实现 2.91 亿元，同比增长 35.05%。 扣除股份支付影响后净利润的改善，反映了公司主营业务盈利能力的积极变化。公司目前仍处于产能爬坡期，随着新增产能逐步释放、量产项目增多及运营效率持续提升，整体盈利能力将进一步改善。感谢您的关注和支持！ Q5：公司未来盈利增长的主要驱动因素有哪些？ 答：尊敬的投资者，您好！公司未来盈利增长的驱动因素主要源于新产品量产导入及前沿技术储备和国内外市场的进一步拓展，具体包括： （1）新产品量产导入及前沿技术储备： 目前，超声波指纹芯片整套声学层及后道封测工艺、图像传感器（CIS）光路层解决方案、半导体玻璃晶圆等已实现量产，后续持续放量有望推动公司盈利能力持续提升。 同时，公司积极布局未来市场，多项新技术取得突破：半导体工艺键合棱镜已开发成功并获得客户认可；MicroLED 项目全流程工艺开发完成并实现小批量投产；多通道色谱芯片光路层产品正以不同工艺持续送样；非制冷红外传感器芯片、压力传感器芯片、微流控芯片及激光雷达等 MEMS 器件已进入工艺选型开发阶段。这些技术积累为公司未来盈利增长奠定了坚实基础。 （2）国内外市场的进一步拓展： 面对市场环境的变化，坚持“国内深耕”与“海外拓展”双线并进：在国内市场，公司聚焦通信、消费电子及智能汽车等领
--	---

	域，强化核心器件的国产化替代，深化与重点客户的战略合作。 在海外市场，公司通过收购海硕力及越南工厂，成功切入三星供应链体系。韩国在光学光电子和半导体领域已形成全球性战略地位，是公司海外拓展的重点市场。另外，通过越南工厂收购，设立海外生产基地，与日本、韩国子公司协同，进一步完善了海外布局。 公司将继续聚焦光学光电子和半导体行业细分领域，紧抓市场机遇，积极推动新技术、新产品的研发与量产，持续提升盈利能力和市场竞争力，以回报广大投资者的支持。感谢您对公司的关注与支持！ Q6：公司的相关产品在无人机低空经济领域有没有应用？ 答：尊敬的投资者，您好！ 公司密切关注包括低空经济在内的新兴产业发展动态，并积极进行技术储备和产品开发。目前，公司有量产的精密光学产品已应用于无人机领域。同时，非制冷红外传感器芯片等 MEMS 器件也处于工艺选型开发阶段，这类传感器在无人机感知系统中具有潜在应用前景。 公司将持续关注低空经济等新兴领域的发展机遇，积极推动相关技术、产品的研发与市场拓展。感谢您的关注与支持！ Q7：公司经营现金流净额同比增长 55.7%，达到 7716 万元，远好于净利润表现，这是如何实现的？这种改善是否可持续？ 答：尊敬的投资者，您好！ 2025 年上半年，公司经营活动产生的现金流量净额同比增长 55.74%，主要是销售商品收到的现金增加，反映了公司主营业务收入的增长和回款管理的加强。感谢您的关注与支持！ Q8：公司是国内少数具备在 12 寸晶圆上提供整套光路层和声学层解决方案能力的企业，这一技术优势的具体应用和商业价值体现在哪些方面？
--	--

	答：尊敬的投资者，您好！公司作为国内少数具备在 12 英寸晶圆上提供整套光路层和声学层解决方案能力的企业，该技术优势的应用与商业价值主要体现在以下几个方面： 在应用方面，公司基于该技术实现了多项产品的量产与推广：超声波指纹芯片整套声学层及后道封测工艺已全面量产；图像传感器（CIS）光路层解决方案实现规模化量产；环境光芯片光路层产品已批量生产；多通道色谱芯片光路层产品正以多种工艺持续送样。 在商业价值方面，该技术构筑了较高的竞争壁垒：相关产品技术复杂度高、客户认证周期长，形成了公司的核心竞争优势。公司未来还将在现有技术平台上持续深化开发，不断拓展新的应用领域，进一步增强可持续发展能力。感谢您对公司的关注与支持！ Q9：AR、VR 和 AI 眼镜是当前令人关注的焦点，对于该领域，贵公司目前有哪些布局 and 规划？ 答：尊敬的投资者，您好！在 AR/VR 眼镜领域，公司依托在光学光电子与半导体领域的核心技术，已实现多项技术突破与产业化成果。目前，公司的高折射率玻璃晶圆持续量产交付，同时 MicroLED 项目已完成全流程工艺开发，并进入小批量投产阶段。感谢您的关注与支持！
附件清单 （如有）	无
日期	2025 年 9 月 10 日